

# **上海万业企业股份有限公司**

## **关于认购上海半导体装备材料产业投资基金 的进展情况公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、基本情况**

2017年4月27日，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次董事会审议通过《关于公司拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易议案》，详情请见公司《关于拟认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的关联交易公告》（公告编号：2017-014），公司拟以自有资金10亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）20%的份额。该议案已经2017年5月19日召开的2016年度股东大会审议通过。

2017年7月21日，上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）参与各方签署《上海集成电路装备材料产业投资基金出资人合作备忘录》，明确了具体出资人、出资额以及基金管理模式（公告编号：2017-027）。

后经工商核准，上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）正式命名为“上海半导体装备材料产业投资基金”（以下简称“基金”）。

2018年1月19日，基金参与各方正式签署《上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。详情请见公司《关于认购上海集成电路装备材料产业投资基金（筹）的进展情况公告》（公

告编号：2018-001)。

2018年8月7日,公司收到上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)通知,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。详情请见公司《万业企业关于认购上海半导体装备材料产业投资基金的进展情况公告》(公告编号:2018-045)。

## 二、进展情况

2018年8月24日,公司收到上海半导体装备材料产业投资管理有限公司的通知,基金已完成首期50.5亿元资金的募集,并按照出资进度首笔到账人民币20.2亿元。基金将正式启动投资项目的运作。

公司将根据基金后续运行情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2018年8月27日